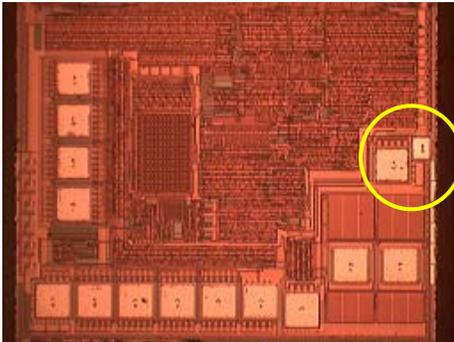


## NY4A & NY4B 邦定注意事项

说明:

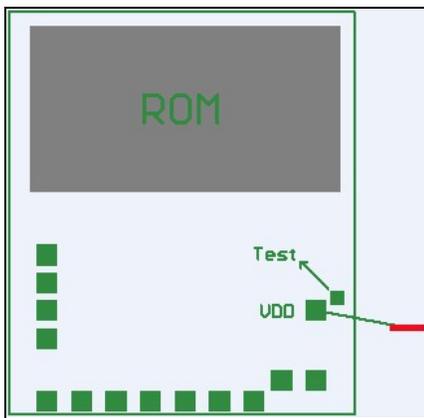
NY4A/NY4B 系列 IC 是在 Test Pad 为高电平时进入 Test Mode, 由于 IC Layout 设计时因为 VDD 的 Pad 很接近 Test Pad。所以客户在 PCB Layout 和邦定时, 如果 PCB 上金手指的位置不对, 则在邦定时打到 VDD 的铝线有机会短路到 Test Pad, 造成 IC 进入 Test Mode, 导致工作不正常。

下图是 NY4B 的 Pad 位置图, 黄色圆圈中较大的 PAD 为 VDD, 较小的为 Test Pad。

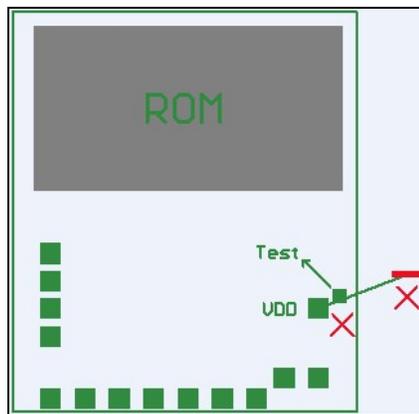


邦定注意说明:

在 PCB Layout 时, PCB 上的 VDD 金手指应尽量放在 IC VDD Pad 的右下方, 这样打线的线头就不容易接触到 Test Pad。如果金手指平放在正对 VDD Pad 的位置或者右上方, 邦定时邦定线头容易接触到 Test Pad, 而进入 Test Mode, 造成大电流和无功能现象。示意图如下:



正确的 PCB 金手指摆放位置



错误的 PCB 金手指摆放位置

下图是实际不良品的邦定现象(不良品挑开 VDD 邦线后的剩余线头图片), 与右边的良品图做比较。

